



(43) 国際公開日 2004 年12 月16 日 (16,12,2004)

国際事務局

**PCT** 

(10) 国際公開番号 WO 2004/109344 A1

(51) 国際特許分類7:

G02B 1/02, 6/12

\_\_\_\_

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/005592

(22) 国際出願日:

2004年4月20日(20.04.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

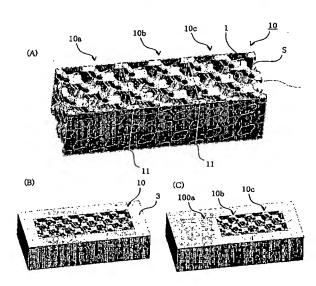
特願2003-161219 2003 年6 月5 日 (05.06.2003) JP

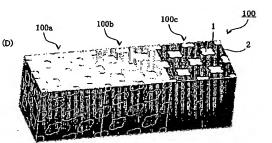
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 村田製作所 (MURATA MANUFACTURING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市天神2丁目26番10号 Kyoto (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 桐原 聡秀 (KIR-IHARA, Soshu) [JP/JP]; 〒5620024 大阪府箕面市栗生新家 2 1 2 7 2 0 5 Osaka (JP). 宮本 飲生(MIYAMOTO, Yoshinari) [JP/JP]; 〒5630057 大阪府池田市槻木町 1 1 4 2 0 2 Osaka (JP). 中川卓二(NAKAGAWA, Takuji) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市天神2 丁目 2 6番 1 0号株式会社 村田製作所内 Kyoto (JP). 田中克彦 (TANAKA, Katsuhiko) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市天神2 丁目 2 6番 1 0号株式会社 村田製作所内 Kyoto (JP).
- (74) 代理人: 小森 久夫 (KOMORI, Hisao); 〒5400011 大阪府大阪市中央区農人橋 1 丁目 4 番 3 4 号 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全での種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

[続葉有]

- (54) Title: THREE-DIMENSIONAL PERIODIC STRUCTURE AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME
- (54) 発明の名称: 3次元周期構造体およびその製造方法





- (57) Abstract: Photonic crystal units (10a, 10b, 10c) are formed by optical molding method using photo-curing resin and a partition (11) is provided at the boundary part. The air gap part of each photonic crystal unit is impregnated with a second substance dispersed with ceramic particles to constitute a filling part (2). Such three-dimensional periodic structures where first and second substances are distributed with a three-dimensional periodicity are arranged sequentially while differentiating the permittivity ratio between the first and second substances. A three-dimensional periodic structure having a photonic band gap of wide range, which is unattainable in the conventional three-dimensional periodic structure, can thereby be obtained.
- (57) 要約: 光硬化性樹脂を用いた光造形法に分割を 100 a が 100 a が

WO 2004/109344 A1

**BEST AVAILABLE COPY** 



ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

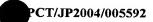
(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY,

CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

#### 一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。



#### 明細書

## 3次元周期構造体およびその製造方法

## 5 技術分野

この発明は、3次元周期構造体およびその製造方法に関するものである

#### 背景技術

10 固体結晶中において、原子核により構成される周期的なポテンシャル分布は、格子定数に見合う波長の電子波に対して干渉作用を示す。すなわち、電子波の波長が結晶のポテンシャル周期に非常に近い場合には、3次元的な回折作用(ブラッグ回折)により反射が起こる。この現象により特定のエネルギ領域に含まれる電子はその通過を禁止される。これが半導体デバイスなどに利用される電子バンドギャップの形成である。

同様に、屈折率もしくは誘電率が周期的に変化する3次元構造は、電磁波に対する干渉作用を示し、特定周波数領域の電磁波を遮断する。この場合、禁止帯はフォトニックバンドギャップと呼ばれ、上記3次元構造体はフォトニック結晶と呼ばれる。

20 上記作用を利用して、フォトニック結晶を、例えば所定周波数帯域の電磁波の透過を遮断するカットオフフィルタとして用いたり、上記周期的な構造中に周期を乱す不均一部分を導入して、その部分に光や電磁波が閉じ込める導波路や共振器として用いたりすることが考えられている。また、光の超低閾値レーザーや電磁波の高指向性アンテナ等への応用も考えられている。

一般にフォトニック結晶中において、電磁波のブラッグ回折が起こると きには、二種類の定在波が形成される。図6はその二種類の定在波を示し

10

15

20

ている。(A)に示す定在波は、波の振動が低誘電率領域で高いエネルギを有し、(B)に示す定在波は、波の振動が高誘電率領域で高いエネルギを有する。この二つの異なるモードにスプリットした定在波間のエネルギを有する波は結晶中に存在できないので、バンドギャップが生じる。

2

このフォトニック結晶には1次元、2次元、3次元の構造体があるが、 完全なフォトニックバンドギャプを得るためには3次元構造が必要である

3次元構造を作るためには、例えば角材積層型(特許文献1、特許文献2)や自己クローニングによる形状保存多層膜を用いた方法(特許文献3)、光造形を用いる方法(特許文献4、特許文献5), 粒子を並べる方法(特許文献6)等がある。これらの公報には、有機材料、セラミック、Si等の絶縁体、誘電体、半導体材料を加工しフォトニック結晶を作る技術が開示されている。また、樹脂組成物および誘電体粒子の混合物を硬化させることにより構成した3次元周期構造体(特許文献7)が開示されている。

【特許文献1】 特表2001-518707公報

【特許文献2】 特開2001-74955公報

【特許文献3】 特開2001-74954公報

【特許文献4】 特開2000-341031公報

【特許文献5】 特表2001-502256公報

【特許文献6】 特開2001-42144公報

【特許文献7】 特開2001-261977公報

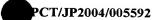
これらのフォトニック結晶から得られるフォトニックバンドギャップは 25 、構成される2つの物質の誘電率や屈折率のコントラストが大きい程大き く広がることが知られている。

しかしながら、これらの実用的な物質は、例えば10~30GHz帯域

10

15

25



での比誘電率は15、屈折率は3.0程度が限界であり、空気との誘電率や屈折率の差(または比)をそれ以上高めることは困難であった。そのため、一定誘電率の誘電体で構成した3次元周期構造体では広範囲なフォトニックバンドギャップが得られなかった。

この問題の解決方法として、種々のバンドギャップを有する周期構造体を重ね合わせてバンドギャップを広げることが考えられる。すなわち、特許文献4に開示されているように、セラミック誘電体材料を分散させた光硬化性樹脂を用いて光造形した構造体や、セラミック誘電体材料を分散させた固体を並べた構造物により格子定数を連続的に変化させたり、誘電率の異なる結晶体を造る方法が有効である。しかしながら、分散させるセラミック材料により、光硬化性樹脂の硬化が阻害されたり、透過率が阻害されて光造形が困難となる。そのため、利用可能な材料が限定され、セラミック誘電体材料の分散量も限られてしまう。

この問題を解消するために、樹脂組成物および誘電体粒子の混合物を硬化させる特許文献7に開示されている方法も有効であるが、誘電体材料を複合化するため、誘電率が低下しやすい。また、セラミック誘電体材料を分散させた熱硬化性樹脂や熱可塑性樹脂塊を並べて構造体を造る方法では、ダイヤモンド構造などの複雑な構造体を得ることは困難である。

一方、特許文献 5 には、光造形で作成した樹脂構造体に高誘電率セラミ 20 ックスを分散させた樹脂を含浸させてフォトニック結晶を作成する方法が 示されている。しかし、この特許文献 5 の開示内容だけでは広範囲なフォトニックバンドギャップを得ることはできない。

そこで、この発明の目的は、従来構造では得られなかった広範囲なフォトニックバンドギャップを有する3次元周期構造体およびその製造方法を 提供することにある。

発明の開示

10

15

20

この発明は、互いに誘電率の異なる第1・第2の物質が3次元空間内で 周期性をもって分布している複数の3次元周期構造体領域を備え、3次元 周期構造体における第1の物質の誘電率と第2の物質の誘電率との誘電率 比を該複数の3次元周期構造体で異ならせたことを特徴としている。

このように、第1・第2の物質の誘電率比が異なった複数の3次元周期 構造体領域を配置したことにより、各3次元周期構造体領域によるフォト ニックバンドギャップの特性を重ね合わせて、広い周波数帯域に亘るフォ トニックバンドギャップを得る。

また、この発明は、互いに誘電率の異なる第1・第2の物質が3次元空間内で周期性をもって分布している複数の3次元周期構造体領域を備え、各3次元周期構造体の平均誘電率に違いをもたせたことを特徴としている

この構造により、上記平均誘電率に応じて周波数帯の異なった位置に現れるフォトニックバンドギャップの重ね合わせにより、広い周波数帯域に 亘るフォトニックバンドギャップを得る。

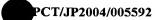
また、この発明は、前記第1の物質を光硬化性樹脂の活性化により硬化 した樹脂とし、該樹脂によって空間部が3次元周期をもって分布した結晶 型部をなし、前記第2の物質を樹脂中にセラミックス粒子が分散した物質 とし、該第2の物質が前記空間部に充填されていることを特徴としている

この構造により、第1の物質による3次元周期構造を高精度且つ容易に 形成し、しかも高誘電率の第2の物質が3次元周期構造をなすように、容 易に構成可能とする。

また、この発明は、前記第1の物質をセラミックス粒子が分散した光硬 25 化性樹脂の活性化により硬化した樹脂とし、該樹脂によって空間部が3次 元周期をもって分布した結晶型部をなし、前記第2の物質を前記空間部に 充填した樹脂としたことを特徴としている。

15

20



この構造によっても、誘電率の異なった第1・第2の物質による3次元 周期構造を高精度且つ容易に構成可能とする。

また、この発明は、前記第2の物質を熱硬化性樹脂または熱可塑性樹脂 とし、該第2の物質を前記空間部に充填した後、熱硬化させたことを特徴 としている。この構造により、全体が固体の3次元周期構造体を容易に構 成可能とする。

また、この発明は、複数の3次元周期構造体を配置するとともに、該配置方向に沿って前記誘電率比を増加方向または減少方向の一方向に傾斜させたことを特徴としている。

10 この構造により、第1・第2物質間の誘電率比の異なる互いに隣接する 3次元周期構造体領域それぞれのフォトニックバンドギャップの重ね合わ せを有効化して、より広範囲に亘って大きなフォトニックバンドギャップ を得る。

また、この発明は、前記周期性の1周期を0.1mm以上30mm以下にしたことを特徴としている。これにより、例えば10~30GHz帯域で大きなフォトニックバンドギャップを有する3次元周期構造体を得る。

また、この発明は、形成すべき断面パターンの光照射を光硬化性樹脂に対して層毎に繰り返す光造形法により、3次元の周期性をもった第1の物質による構造体を光造形し、且つ該3次元周期構造体を複数の領域に区分する仕切りを設ける工程と、樹脂中にセラミックス粒子が分散され、該セラミックス粒子の含有比率が異なる複数種の第2の物質を、前記第1の物質による構造体の各領域内の空間部に真空脱泡法によりそれぞれ充填する工程と、前記第2の物質を硬化させる工程と、から3次元周期構造体を得ることを特徴としている。

25 このように、第1の物質による構造体を仕切りによって複数の領域に区分して、各領域内にそれぞれセラミックス粒子の含有比率の異なる複数種の第2の物質を充填することによって、第1・第2の物質の誘電率比が異

10

15

なった複数の3次元周期構造体領域を容易に配置可能とする。

#### 図面の簡単な説明

図1は第1の実施形態に係る3次元周期構造体の1単位の構造を示す斜視図である。図2は同3次元周期構造体の製造工程を示す図である。図3は第2の物質の含浸充填工程を示す図である。図4は光造形装置の構成を示す図である。図5は同光造形装置によるオブジェクトの造形途中の状態を示す図である。図6は誘電率の異なる物質が周期性を持って分布しているときの2つの定在波を示す図である。図7は3次元周期構造体の電磁波特性装置の構成を示す図である。図8は電磁波特性の測定結果を示す図である。図9は第2の実施形態に係る3次元周期構造体の1単位の構成を示す斜視図である。図10は同3次元周期構造体の電磁波特性の測定結果を示す図である。図11は第3の実施形態に係る3次元周期構造体の構成を示す図である。図12はフォトニック結晶型部に対するチタン酸カルシウムの分散量と比誘電率との関係を示す図である。

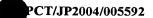
### 発明を実施するための最良の形態

この発明の第1の実施形態に係る3次元周期構造体およびその製造方法について各図を参照して順次説明する。

20 図 2 は、3 次元周期構造体の製造過程の状態を示している。(A)は、フォトニック結晶型 1 0 の斜視図である。このフォトニック結晶型 1 0 は、3 つのフォトニック結晶型ユニット 1 0 a, 1 0 b, 1 0 c を連結した構造をなす。各フォトニック結晶型ユニットはフォトニック結晶型部 1 からなり、空隙部 2 を有している。このフォトニック結晶型部 1 は後に示すように、第 1 の物質である比誘電率 2.2 のエポキシ系の光硬化性樹脂を用いて光造形法で作成されている。また、隣接するフォトニック結晶型ユニットの境界部分には仕切り 1 1 を設けていて、隣接するフォトニック結

15

20



晶型ユニットの空隙部2同士が連通しない構造にしている。

フォトニック結晶型ユニット10a, 10b, 10cは、格子定数12mmのダイヤモンド結晶格子を縦2列、横2列、高さ2列分それぞれ備え、3次元周期構造を成す。

5 図2の(B)は、このフォトニック結晶型ユニット10をポリテトラフルオロエチレン製の含浸用型3に入れた状態を示している。

その後、図3に示すように、カバー5で不要な部分を覆って、所望のフォトニック結晶型ユニットに第2の物質を含浸させる。すなわち、そのフォトニック結晶型ユニットの空隙に第2の物質を充填する。図3に示した例では、フォトニック結晶型10a部分を開口させてカバー5を覆い、フォトニック結晶型10a部分に第2の物質を含浸させて、図2の(C)に示すように、3次元周期構造体ユニット100aを構成する。

同様にして、フォトニック結晶型ユニット10b, 10cにも第2の物質を含浸させる。但し、フォトニック結晶型ユニット10a, 10b, 10c毎に第2の物質の比誘電率を異ならせる。

上記第2の物質としては、ポリエステル樹脂にチタン酸カルシウムを分散させた樹脂を用いる。具体的には、ポリエステル樹脂として株式会社日本触媒製の「エポラックG-110AL」を用い、硬化剤として日本油脂株式会社製の「パーメックN」を用い、両者を混合して比誘電率3の硬化性ポリエステル樹脂を用意する。それに対して平均粒径1.5 $\mu$ m、比誘電率180のチタン酸カルシウムを、硬化性ポリエステル樹脂に対して所定割合だけ混合し、攪拌し、真空脱泡する。このことによって未硬化状態の第2の物質を得る。チタン酸カルシウムの割合として、この例では30v01%,25v01%,20v01%03種類とする。

25 上記チタン酸カルシウムの割合の異なった未硬化状態の第2の物質を、 図2に示した含浸用型3内に入れたフォトニック結晶型ユニット10a, 10b, 10cに順に含浸させ、さらに含浸用型ごと全体を真空容器内に

入れ、排気ポンプで排気することによって真空脱泡する。

その後、上記第2の物質を硬化させて、図2の(D)に示すような3次元周期構造体100を得る。(D)において2は、フォトニック結晶型部1の空隙部に充填した第2の物質による充填部を示している。

5 図4は、図2の(A)に示したフォトニック結晶型10を製造する装置を示している。ここで、容器25には紫外線で硬化するエポキシ系の光硬化性樹脂28を満たしている。容器25の内部には上下方向に移動するエレベータテーブル26を設けている。このエレベータテーブル26の上部にオブジェクト29を造形する。光硬化性樹脂28の液面付近にはオブジェクト29の上面に光硬化性樹脂28を所定膜厚だけ塗布するためのスキージ27を設けている。

また、光学系としては、レーザーダイオード20、レーザーダイオード20からのレーザー光を波長変換して紫外光を発生させる調波発生素子(LBO)21、波長選択素子としての音響光学素子(AOM)22、走査ミラー23、f0レンズ24を設けている。

このような光造形装置を用いたフォトニック結晶の製造手順は次のとおりである。

まず、エレベータテーブル26を光硬化性樹脂28の液面から所定深さまで降下させ、スキージ27を液面に沿った方向に移動させることによって、エレベータテーブル26の表面に厚さ約100μmの光硬化性樹脂膜を形成する。その状態で、(B)に示すように上記光学系によって波長355nmの紫外線レーザーをスポット径50μmのレーザビームLBとして出力110mWでその液面LSに照射する。このとき走査ミラー23を制御しつつレーザーダイオード20を変調することによって、光硬化性樹128を硬化させるべき位置にレーザー光を照射し、その他の領域に照射しないように制御する。

上記レーザービームの照射された光硬化性樹脂28の液面は、その重合

15

20

25

反応により直径約 $100\mu$ mの球状硬化相PRが形成される。この時、レーザービームを速度90m/sで走査すると、厚さ約 $150\mu$ mの硬化相が形成される。

このようにレーザービームをラスタースキャンすることによって一層目 5 の断面パターンに相当するオブジェクト29を形成する。

次に、エレベーターテーブル 26 を液面に対して約  $200 \mu$  m降下させ、スキージ 27 の移動によって、オブジェクト 29 の表面に厚さ約 200  $\mu$  mの光硬化性樹脂膜を形成する。

その後、一層目と同様にしてレーザービームの走査および変調を行うことによって二層目の断面パターンを一層目の上に形成する。この時、上下の層は重合硬化により接合される。三層目以降は二層目と同様である。この処理を繰り返すことによってオブジェクト29を造形する。

図5は、多数の層を形成した各段階でのオブジェクトの形状を透視斜視図として示している。(A)は、ダイヤモンド構造の結晶軸〈111〉方向に略1ユニット分だけ造形した状態を示している。また(B)は、これを約4ユニット分造形した状態を示している。(C)は、更にこれを所定ユニット分繰り返して造形した状態を示している。

図4に示した装置で、光硬化性樹脂28の液面に対して所定の断面パダーンで光硬化性樹脂28を硬化させるために、CAD/CAMプロセスを用いる。すなわち、図5に示したようなパターンは、3次元データを扱うCADで予め設計し、その3次元構造のデータを一旦STL (Standard Triangulation Language) データに変換し、これをスライスソフトウェアによって、所定位置における2次元断面データの集合へ変換する。最後に、この2次元断面データからレーザービームをラスタースキャンさせる際にレーザーダイオードを変調するためのデータを作成する。このようにして用意したデータを基に、レーザービームの走査とともにレーザーダイオードの変調を行う。

25

以上の手順で造形した光硬化性樹脂によるオブジェクト29を容器25から取り出し、未硬化の光硬化性樹脂を洗浄し、乾燥させ、さらに所定サイズに切断することによって、図2の(A)に示したフォトニック結晶型ユニット10を構成する。

5 図1は、1単位のダイヤモンド結晶格子を示している。ここで1はフォトニック結晶型部、Sは空隙部である。このダイヤモンド構造は、単位格子に8個の格子点を含み、そのうち4個ずつがそれぞれ独立の面心立法格子をつくり、一方の格子が他方を立体対角線に沿ってその長さの1/4だけ平行に移動した位置を占めるものである。

10 上述したように、フォトニック結晶型ユニット10a,10b,10cは、それぞれ格子定数12mmのダイヤモンド結晶格子を縦2列、横2列、高さ2列分それぞれ備えている。隣接するフォトニック結晶型ユニット同士の境界部分の仕切り11は、上記光造形法によって、フォトニック結晶型ユニット10a,10b,10c部分と同時に形成する。または、フォトニック結晶型ユニット10a,10b,10cを個別に作成し、仕切り11となるシートを挟んで接着するようにしてもよい。

図7は、3次元周期構造体100の特性を測定する測定装置を示している。この測定装置には、Mバンド導波管30と、その導波管30内に挿入したプローブ31,32を備えている。この導波管30の内部に試料としての3次元周期構造体100を挿入する。プローブ31,32にはネットワークアナライザ33を接続している。このネットワークアナライザ33を用いて電磁波の伝搬特性を測定する。図7において3次元周期構造体100は、3つの3次元周期構造体ユニットの連結方向(長手方向)が導波管30の電磁波伝搬方向を向くように配置している。導波管30の内側寸法は、横20×縦10mmであり、3次元周期構造体100の寸法は導波管30の長手方向に20mm、導波管30の高さ方向に10mmである。

図8は、上記3次元周期構造体の電磁波伝搬特性を示している。 (A)

は比較のために、第2の物質に分散させるチタン酸カルシウムの割合を10%、20%、30%のそれぞれについて測定した伝搬特性を示している。(B)の(1)は、チタン酸カルシウムを20%分散させた3次元周期構造体ユニットと、チタン酸カルシウムを30%分散させた3次元周期構造体ユニットとを2連結した3次元周期構造体の伝搬特性を示している。また、(2)は、図2の(D)に示したように、チタン酸カルシウムを20%、25%、30%それぞれ分散させた3次元周期構造体ユニットを3連結した3次元周期構造体の伝搬特性を示している。

ここで、図2の(D) に示した各3次元周期構造体ユニット100a, 10 100b, 100cのフォトニック結晶型部1(第1の物質)と充填部2 (第2の物質)の比誘電率は表1のとおりである。

〔表1〕

20

3次元周期構造体ユニット		100a	100b	100c		
チタン酸カルシウム(vol%)	10	20	25	30	40	
比誘電率	4. 2	6. 1	8. 0	9.8	12.0	
誘電率比	1.9	2.8	3. 6	4. 5	5. 5	
誘電率比の変化率		└1. 28份	뱤ᅴ └1.2	5倍」 └1.	22倍二	
		└───1.6倍────				

なお、表1において、チタン酸カルシウムを40%分散させた例は、後 15 に引用する。

図8の(A)のように、第1・第2の物質の誘電率比が一定であれば、 広範囲のフォトニックバンドギャップは得られない。また、(B)の(1) のように、隣接する3次元周期構造体間での第1・第2の物質の誘電率比 の変化率が大きいと、広いバンドギャップが得られない。(2)のように、 第1・第2の物質の誘電率比に違いをもたせ、且つ隣接する3次元周期構

10

造体間での第1・第2の物質の誘電率比を変化させることによってバンドギャップの広帯域化が図れる。特に、本実施形態のように、隣接する3次元周期構造体の誘電率比を3次元周期構造体の配置方向に沿って増加方向または減少方向の一方向に傾斜させることにより、広い周波数帯で充分な減衰量を得ることができる。

次に、第2の実施形態に係る3次元周期構造体について、図9および図 10を参照して説明する。

この3次元周期構造体は、第1の実施形態に係る3次元周期構造体と異なり、ダイヤモンド結晶格子部分を空隙としている。図9はその1単位の結晶格子を示している。ここで、1は第1の物質からなるフォトニック結晶型部、Sはその空隙部である。また、この第2の実施形態では、3連結したそれぞれの3次元周期構造体ユニットは、チタン酸カルシウムの分散量が20%,30%,40%の3種としている。その他の構造および製造方法は第1の実施形態の場合と同様である。

15 図10は、上記3次元周期構造体の電磁波伝搬特性を示している。(A) は比較のために、第2の物質に分散させるチタン酸カルシウムの割合を20%、30%、40%のそれぞれについて測定した伝搬特性を示している。(B)の(1)は、チタン酸カルシウムを20%分散させた3次元周期構造体ユニットを2連結した3次元周期構造体の伝搬特性を示している。また、(2)は、チタン酸カルシウムを40%分散させた3次元周期構造体ユニットと、30%分散させた3次元周期構造体ユニットと、30%分散させた3次元周期構造体ユニットと、30%分散させた3次元周期構造体ユニットと2連結した3次元周期構造体の伝搬特性を示している。(3)は、チタン酸カルシウムを20%、30%、40%それぞれ分散させた3次元周期構造体ユニットを3連結した3次元周期構造体ユニットを3連結した3次元周期構造体の伝搬特性を示している。

このように、3次元周期構造体毎に第1・第2の物質の誘電率比に違いをもたせ、且つ隣接する3次元周期構造体間での第1・第2の物質の誘電



率比を変化させることによってバンドギャップの広帯域化が図れる。

次に、第3の実施形態に係る3次元周期構造体について、図11および 図12を参照して説明する。

13

図11は、3連結構造の3次元周期構造体を示している。この例では、フォトニック結晶型部10a,10b,10cのそれぞれを構成する第1の物質として、光造形樹脂である比誘電率2.8のエポキシ樹脂に対してチタン酸カルシウムを分散させている。しかも、フォトニック結晶型ユニット10a,10b,10cのそれぞれについてチタン酸カルシウムの濃度を異ならせている。図中Uは各ユニットの範囲を示している。

10 図12は、上記エポキシ樹脂に対するチタン酸カルシウムの分散量に対する比誘電率の関係を示している。ここで、各フォトニック結晶型ユニット10a,10b,10cの空隙部を空気のままとすることによって、各3次元周期構造体の第1・第2の物質の誘電率比に違いをもたせることができる。

15 また、更に各フォトニック結晶型ユニットの空隙部に所定比誘電率の樹脂を含浸させることによって、各3次元周期構造体ユニットにおける第1・第2の物質の誘電率比を一定にしたまま各ユニットの平均誘電率に違いをもたせることができる。

ここで、「平均誘電率」とは、「第1の物質の比誘電率と第2の物質の 20 比誘電率との和を2で割った値」で定義されるものである。すなわち、第 1の物質の比誘電率と第2の物質の比誘電率を、隣接する3次元周期構造 体同士で異ならせることによって、第1・第2の物質の誘電率比を一定に しつつ、隣接する3次元周期構造体における平均誘電率を異ならせること ができる。

25 このような場合、フォトバンドギャップの周波数軸上の位置はユニット 全体の平均誘電率に依存し、フォトバンドギャップの鋭さと広がりは各ユ ニットにおける第1・第2の物質の誘電率比に依存する。そのため、各ユ

20

25

ニットの第1・第2の物質の誘電率比を略一定にしたまま平均誘電率の異なった複数の3次元周期構造体ユニットを組み合わせることによって、広範囲な波長で一定の減衰を成すフォトニックバンドギャップを得ることができる。

5 第1~第3の実施形態に示したように、各3次元周期構造体ユニットを構成することによって、広い周波数帯で一定の減衰を成すフォトニックバンドギャップが得られる。また、表1に示した誘電率比の変化率を参照し、図10(B)の特性(1)と特性(2)を比較すると明らかなように、隣接する3次元周期構造体同士の誘電率比の変化率が大きくなると2つの減衰10 極Pa,Pbの間隔が広がり過ぎて充分な減衰量が得られなくなる。したがって、充分な減衰量を得るためには、隣接する3次元周期構造体同士の誘電率比の変化率が2.0以下、さらには図10(B)の(1)に示した特性より良好な特性が得られるように1.6以下とすることが望ましい。

因みに、バンドギャップの周波数帯を広げるためには、含浸させる第2の物質の誘電率は一定にしておき、格子定数を変えることが考えられる。例えば、格子定数が12mm、13mm、14mmの3次元周期構造体を組み合わせる。このような構造では、目的とする周波数帯域にバンドギャップを得るために、3次元周期構造体の各ユニットの大きさが不ぞろいになる、という問題が生じる。また、より高周波帯域でフォトニックバンドギャップを得るために、格子定数の小さな3次元周期構造体を必要とするが、小さな格子定数の部分にはセラミック分散樹脂を含浸させにくく、その製造が困難になるという問題も生じる。

なお、以上の各実施形態では、フォトニック結晶型ユニット10a,10b,10cを低誘電率樹脂とし、その空隙部に高誘電率樹脂を充填したが、これを逆に、フォトニック結晶型ユニットの空隙部に充填する樹脂をフォトニック結晶型ユニットより低誘電率としてもよい。

また、以上の各実施形態では、3次元周期構造体の1周期を12mmと

したが、同様にしてこの周期を0.1mm以上30mm以下にすることにより、 $10\sim30$  GHz 帯域で大きなフォトニックバンドギャップを有する3次元周期構造体を得ることができる。

## 5 産業上の利用可能性

この発明は、光や電磁波の透過を遮断するフィルタとして、光や電磁波 を閉じ込める導波路や共振器として、あるいはレーザやアンテナ等として 利用可能である。

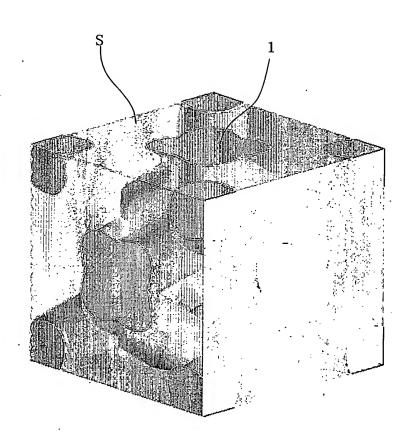
25

#### 請 求 の 範 囲

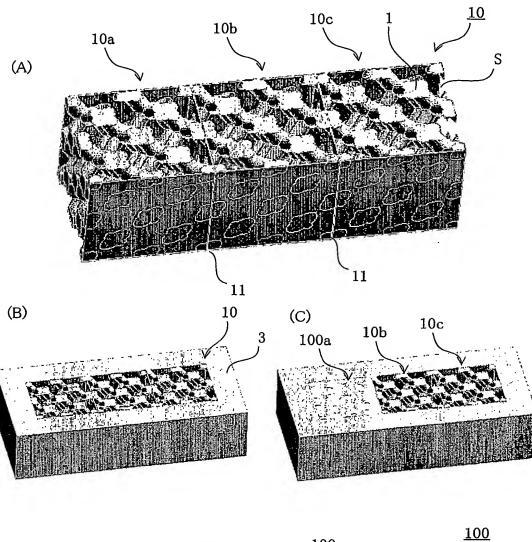
- (1) 互いに誘電率の異なる第1・第2の物質が3次元空間内で周期性を もって分布している複数の3次元周期構造体領域を備え、3次元周期構造 体における第1の物質の誘電率と第2の物質の誘電率との誘電率比を該複 数の3次元周期構造体で異ならせたことを特徴とする3次元周期構造体。
- (2) 互いに誘電率の異なる第1・第2の物質が3次元空間内で周期性を もって分布している複数の3次元周期構造体領域を備え、各3次元周期構 造体の平均誘電率に違いをもたせたことを特徴とする3次元周期構造体。
- 10 (3) 前記第1の物質は光硬化性樹脂の活性化により硬化した樹脂であり、該樹脂によって空間部が3次元周期をもって分布した結晶型部をなし、前記第2の物質は樹脂中にセラミックス粒子が分散した物質であり、該第2の物質を前記空間部に充填したことを特徴とする請求項1または2に記載の3次元周期構造体。
- 15 (4) 前記第1の物質はセラミックス粒子が分散した光硬化性樹脂の活性 化により硬化した樹脂であり、該樹脂によって空間部が3次元周期をもっ て分布した結晶型部をなし、前記第2の物質は樹脂であり、該第2の物質 を前記空間部に充填したことを特徴とする請求項1または2に記載の3次 元周期構造体。
- 20 (5) 前記第2の物質は熱硬化性樹脂または熱可塑性樹脂であり、該第2 の物質を前記空間部に充填した後、熱硬化させたことを特徴とする請求項 1~4のいずれかに記載の3次元周期構造体。
  - (6)複数の3次元周期構造体を配置するとともに、該配置方向に沿って 前記誘電率比を増加方向または減少方向の一方向に傾斜させた請求項1~ 5のいずれかに記載の3次元周期構造体。
  - (7) 前記周期性の1周期を0.1 [mm] 以上30 [mm] 以下にした ことを特徴とする請求項1~6のいずれかに記載の3次元周期構造体。

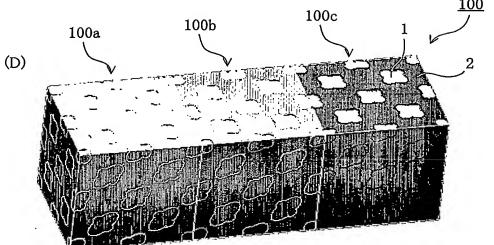
- (8) 形成すべき断面パターンの光照射を光硬化性樹脂に対して層毎に繰り返す光造形法により、3次元の周期性をもった第1の物質による構造体を光造形し、且つ該3次元周期構造体を複数の領域に区分する仕切りを設ける工程と、
- 5 樹脂中にセラミックス粒子が分散され、該セラミックス粒子の含有比率 が異なる複数種の第2の物質を、前記第1の物質による構造体の各領域内 の空間部に真空脱泡法によりそれぞれ充填する工程と、

前記第2の物質を硬化させる工程と、からなる3次元周期構造体の製造 方法。

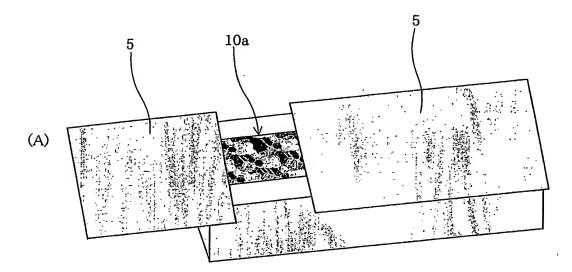


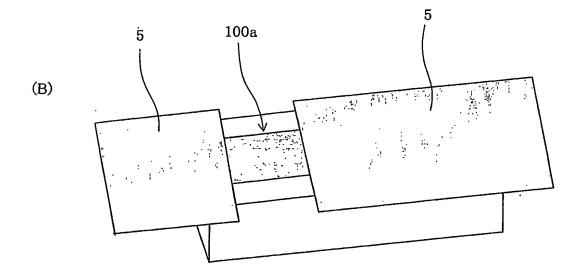
2/12 図 2



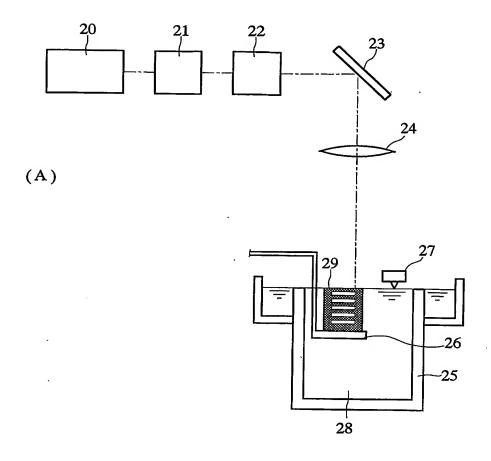


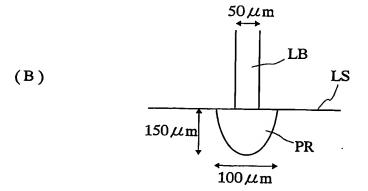
3/12 図 3

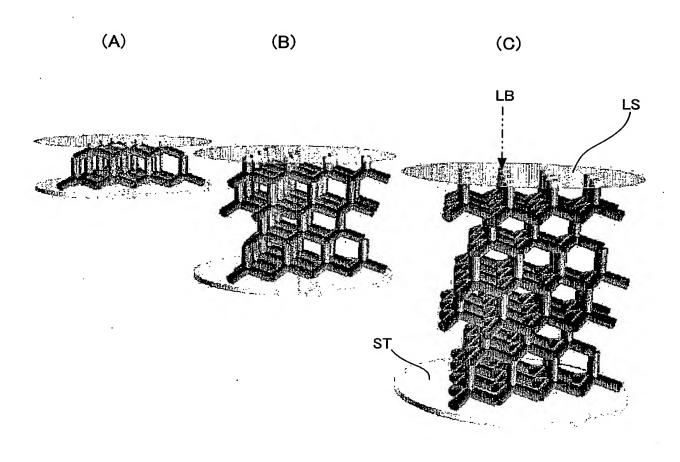




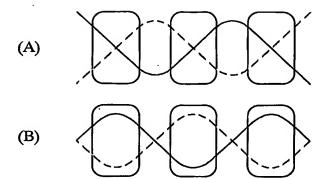
4/12 図 4



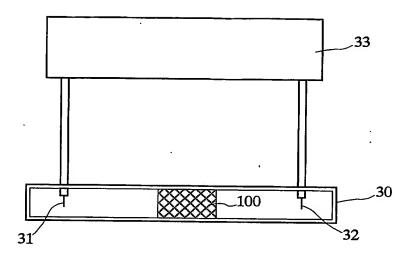




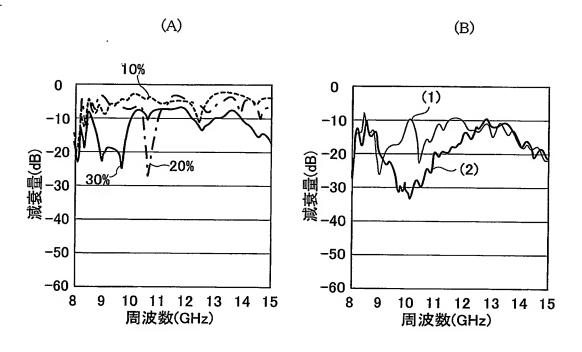
6/12 図 6

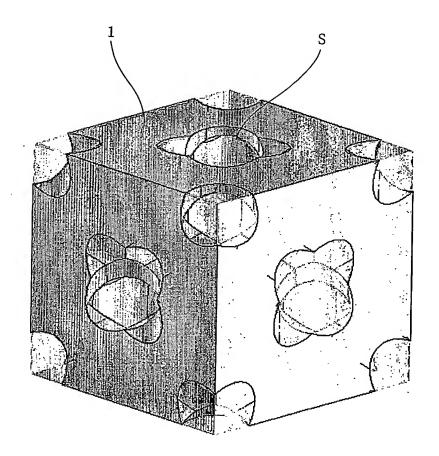


7/12 図 7

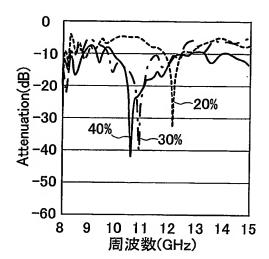


8/12 図 8

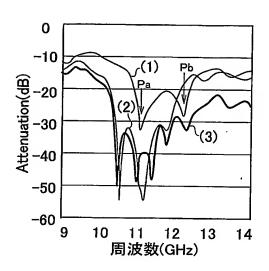


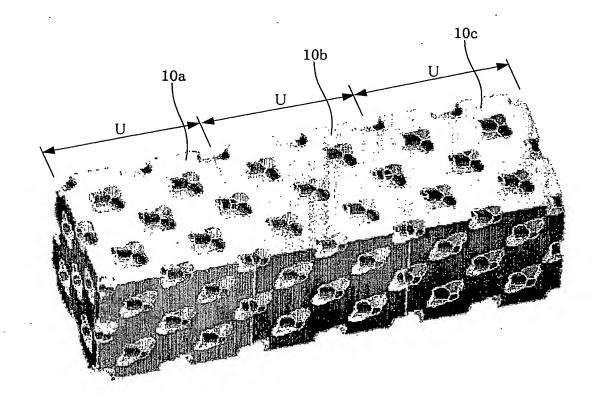


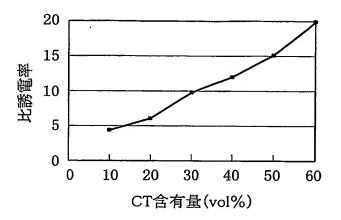
(A)



(B)









International application No.

			PCT/JP2004/005592	
A. CLASSIFI Int.Cl	CATION OF SUBJECT MATTER 7 G02B1/02, G02B6/12			
According to In	ternational Patent Classification (IPC) or to both natio	nal classification and IPC		·
B. FIELDS SI	EARCHED			<u> </u>
Minimum docur	mentation searched (classification system followed by	classification symbols)		•
Int.C1	<sup>7</sup> G02B1/02, G02B6/12			
Documentation	searched other than minimum documentation to the ex	tent that such documents are	included in the fields s	earched
		Jitsuyo Shinan Toro		
		oroku Jitsuyo Shir	•	
	base consulted during the international search (name of	f data base and, where pract	cable, search terms used	i)
Category*				
X	Citation of document, with indication, where a	•	-	vant to claim No.
Ŷ	JP 2002-71981 A (Fuji Photo 12 March, 2002 (12.03.02),	Film Co., Ltd.	•	1,2,6 3-5,7
	Claims; Par. Nos. [0023], [0			3 3, ,
	& US 2002/0041425 A1 & EI	P 1184690 A2	ļ	
. Y	JP 2000-341031 A (Kabushiki	Kaisha Ion Koga	ıku	3-7
, A	Kenkyusho),			8
	08 December, 2000 (08.12.00) Claims; Par. Nos. [0007], [0	, 0121 [0015] [	00101	
	(Family: none)	012], [0015], [	,010]	
		•	1	
		•		
			İ	
		•		
Further do	cuments are listed in the continuation of Box C.			
		See patent family a		
"A" document de	gories of cited documents: efining the general state of the art which is not considered	date and not in conflic	ed after the international f t with the application but c	filing date or priority ited to understand
to be of parti	icular relevance cation or patent but published on or after the international	the principle or theory	underlying the invention	
filing date		considered novel or o	relevance; the claimed in cannot be considered to in	vention cannot be ivolve an inventive
cited to esta	hich may throw doubts on priority claim(s) or which is ablish the publication date of another citation or other	step when the docume "Y" document of particular	relevance: the claimed inv	rention cannot be
	on (as specified) ferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	considered to involv	e an inventive step when more other such documents	the document ic
"P" document pu the priority d	blished prior to the international filing date but later than	being obvious to a per	son skilled in the art	·
		"&" document member of t	ne same patent family	
Date of the actual	completion of the international search	Date of mailing of the int		
og oune	2, 2004 (04.06.04)	22 June, 20	004 (22.06.04)	
Name and mailing	g address of the ISA/	Authorized officer		
	se Patent Office	- Audio11264 Office1		-
Facsimile No.		Telephone No.		
orm PCT/ISA/210	0 (second sheet) (January 2004)			



A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))				
Int. Cl' G02B1/02, G02B6/12	2			
B. 調査を行った分野				
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))				
Int. Cl' G02B1/02, G02B6/12				
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの				
日本国実用新案公報 1922-1996	3年			
日本国公開実用新案公報 1971-2004				
日本国実用新案登録公報 1996-2004 日本国登録実用新案公報 1994-2004				
		·····		
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、	、調査に使用した用語) ・			
		<i>;</i>		
C. 関連すると認められる文献				
引用文献の		関連する・		
カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連する	テゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示			
X JP 2002 - 71981 A (富士写真フィル	1, 2, 6			
【特許請求の範囲】,【0023】,【002		1		
Y & US 2002/0041425 A1 & EP 11846	690 A2	3-5, 7		
Y JP 2000 - 341031 A (株式会社イオン	ン工学研究所) 2000.12.08、	3-7		
【特許請求の範囲】,【0007】,【001				
A  ミリーなし)				
	·			
○個の体をはず本地は別様ととって				
C欄の続きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー	の日の後に公表された文献	•		
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの	「T」国際出願日又は優先日後に公表さ			
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日	出願と矛盾するものではなく、¾ の理解のために引用するもの	発明の原理又は理論		
以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明				
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの				
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)	「Y」特に関連のある文献であって、当	当該文献と他の1以		
「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献	上の文献との、当業者にとって自 よって進歩性がないと考えられる	目明である組合せに		
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファミリー文献	, we c		
「同欧部大・ウマートロ		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
国際調査を完了した日 04.06.2004	国際調査報告の発送日 22.6	. 2004		
国際調査機関の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	2V 3309		
日本国特許庁(ISA/JP)	森内 正明			
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	<b>姑娘</b> 0.07~		
NAME I MEERA MO-1 H 4EO O	毎胎無な	とは かな ひ と イ 】		

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:		
☐ BLACK BORDERS		
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES		
☐ FADED TEXT OR DRAWING		
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING		
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES		
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS		
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS		
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT		
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY		

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.